

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-1107

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他	
参与单位名称	（排名不分先后） 兴全基金、鹏华基金、中欧基金、建信保险、东方阿尔法、源乐晟、国联基金、Cloud alpha capital、惠升基金、和谐汇一、运舟资本、交银理财、华商基金、圆信永丰、银河基金、万家基金、泰信基金、国投瑞银、中庚基金、交银基金、浙商资管、泰康资产、瑞银资产、建信基金、宏利基金、景顺长城、汇丰晋信、兴银基金、永赢基金、富国基金、招商基金、嘉实基金、华夏基金、易方达、银华基金、鑫元基金、国君资管、泉果基金、上银基金、太平资产、国泰基金、云峰基金、长江养老、中泰电子、华泰电子、华金电子、国泰海通、长江证券、国信证券、西部证券	
时间	2025 年 11 月 3 日至 11 月 7 日	
上市公司接待人员姓名	董事长、首席战略官	戴保家
	董事、副总经理	赵锡凯
	董事、董事会秘书、副总经理	韩旻
	投资者关系总监	董跃飞
投资者关系活动主要内容介绍	问：刚回片的第二代 4G 八核手机芯片测试情况如何？预计推向客户验证的时间节点？ 答：目前该芯片的各项验证工作有序进行中，关键功能的验证结果均符合预期，部分超出设计目标。该芯片搭载 20TOPS 算力 NPU，支持多种主流大模型（如：阿里云通义千问、DeepSeek、Llama 等）端侧部署，可支持文本问答、	

	实时翻译、AI 图片生成与编辑、视频超分辨率处理等多模态离线端侧应用，能够为终端用户带来更好的 AI 交互体验，具备主流中高端手机平台的表现水平。同时本芯片也是目前同类 4G 智能手机芯片中唯一能支持 LPDDR4x/5/5x 等多种高带宽存储器的解决方案，相关存储器接口测试结果良好，能够帮助客户更有效地应对当前存储市场供应不断变化的情况。该芯片预计将在今年年底开始客户导入验证工作。 问：公司第一代 4G 八核 SoC 市场推广的情况怎样？ 答：公司的第一代 4G 八核 SoC（22nm）已经推向市场，在多个方面都取得了良好进展。 在智能机市场，首发客户 G-Tab 的智能手机已经于 8 月底上市，主要面向中东、北非市场销售。第二个手机客户为南非最大零售渠道的自有品牌，目前产品已经完成了当地运营商认证，预计明年年初面世。第三个客户的手机产品预计在明年一季度量产，同步面向国内和海外市场推广。此外，还有近 10 个智能手机项目正在推进中。 在非手机市场，车机方面搭载公司芯片方案的天际通新一代智能车机已经上市，此外还有其它智能车机项目正在进行中；智能平板方面，首发客户已经出货，目标东南亚、日本市场，同时公司另有 10+项目正在推进中；桌面陪护型机器人方面，已经有客户的项目实现小批出货。 问：公司的目前第一代 4G 八核项目中是否有原 4G 四核手机客户的项目？ 答：目前，所有原 4G 四核智能手机客户均已有项目导入或者正在导入公司的第一代 4G 八核芯片，且存在单个客户连续导入多个项目的情况。老客户持续拓展与公司的合作，持续导入新产品，证明了客户对公司产品、技术及服务
--	---

	的认可。 问：在智能手机 SoC 领域，公司对后续产品有无明确规划，能否介绍一下？ 答：公司对智能手机 SoC 产品线有明确的产品规划，下一步将持续进行 5G-A 及 6G 方向的研发工作，同时加大在 AI 大模型垂直应用方面的研发投入，并不断提升 CPU/GPU/多媒体等的性能指标。 问：公司 5G RedCap 产品的布局和后续规划是什么？ 答：RedCap 作为 5G 终端的重要连接类型，补齐了 5G 统一空口下的中端速率业务需求，公司在此领域已经完成了充分布局，产品覆盖从模组、轻量化穿戴、智能终端到安卓平台等多种形态，具备较强的先发优势。目前，公司在 5G RedCap 方面已形成商业支撑能力，后续将结合市场需求及应用场景的情况丰富解决方案，形成更加立体化的产品系列。 问：公司在蜂窝通信领域的发展策略是怎样的？物联网蜂窝和智能手机蜂窝的投入有何调整？ 答：公司在蜂窝物联网领域的产品布局已较为齐全，目前拥有几十款产品，细分赛道领导地位已经显现，从公司运营的角度看，相对于投入来说，这类产品将进入收益回收期。智能手机 SoC 是未来公司蜂窝投入的主力方向，尤其在 5G-A 及 5G+AI 方面，后续将结合市场需求及应用场景的情况丰富解决方案，形成更加立体化的产品系列，从而稳步提升市场规模，争取获得较高的市场份额。 问：目前市场上 DDR4 的缺货对公司业绩有影响吗？ 答：公司目前主力出货产品包括 Cat.1、Cat.4、Cat.7 以
--	---

	及 5G RedCap 等产品基本不受影响。而在 4G 四核和第一代 4G 八核智能手机芯片项目上，因客户端自采的 LPDDR4/4X 缺货，会在一定程度上影响对公司主芯片的提货数量。但公司 9 月回片的第二代 4G 八核智能 SoC 芯片是目前市场上唯一支持 LPDDR4/4X/5/5X 的 4G 手机芯片，这个差异化的性能有助于公司后续的市场推广。 问：请问贵司蜂窝基带产品在东南亚市场的推广情况怎样？ 答：目前，公司蜂窝基带产品在东南亚市场的推广已取得阶段性成果，多个合作项目正在稳步推进中，其中部分项目已实现大规模量产出货。近期，公司还荣获东南亚地区最大运营商授予的“战略合作伙伴大奖”，进一步夯实了在当地市场的合作基础与品牌影响力。 问：蜂窝物联网市场三四季度需求怎么样？客户需求是否会受到国补退坡影响？ 答：从第三季度出货情况来看，出货量并没有下滑，环比第二季度无论是收入还是出货量均取得增长，但环比增速不高，其中 9 月份出货量稍弱于 7 月、8 月。从客户提供的滚动需求的情况来看，有少量客户下修了第四季度或者明年第一季度的需求量，公司评估全球经济形势、部分终端去库存、供应链上存储缺货等可能都是影响因素。 问：公司第三季度收入构成环比第二季度有什么变化？ 答：公司第三季度实现营收 9.8 亿，细拆各业务板块的情况：蜂窝基带芯片各门类产品销售环比第二季度均取得小幅增长，智能手机 SoC 芯片销量继续增长，同时 5G RedCap 也有了一定的出货量，蜂窝基带芯片整个业务板块的毛利率
--	--

	环比改善。 在定制业务和 IP 授权业务板块方面，主要受收入确认方式的影响，第三季度收入确认很少，环比第二季度收入下降 50% 左右。公司当前定制业务正在执行项目较多，且单体金额较大，复杂程度较高，距离交付尚需一定时间。后续随着多个项目的验收交付，预计明年收入将实现大幅增长。 问：公司 2025 年定制业务订单签订情况如何？从新签订单来看，增量主要来自那些类型的产品？ 答：公司目前定制业务在手订单丰富，2025 年前三季度订单总金额较 2024 年同期有倍数级增长。定制业务的增量订单主要来自于穿戴/眼镜类芯片、云端推理 AI 芯片和 RISC-V 芯片。 问：高通反垄断调查，对于公司的影响如何？后续公司对 V2X 等产品是否有相应规划？ 答：从行业生态视角，这类监管行动本质上是对市场秩序的规范，长远来看有助于降低国产供应链对单一外部资源的依赖，而公司作为国产芯片供应链中的重要参与者，能在这一生态优化进程中获得相应的发展机遇。 公司目前暂无直接用于 V2X 的产品。如果市场需求明确，公司有技术和能力快速研发出相应产品。 问：公司在 AI 方面有哪些技术能力？ 答：公司具备自主研发 AI 技术与高灵活适配能力，自研 NPU IP 可支持 CNN（卷积神经网络）、RNN（循环神经网络）、Transformer 等主流 AI 模型；研发团队具备从硬件加速器设计、算法优化，到软件栈开发、工具链搭建的全栈开发能力。NPU 架构灵活，能覆盖从小于 1 TOPS 到数十 TOPS
--	--

	的算力，可灵活匹配不同产品的性能需求。在应用场景方面，公司的 AI 能力既适配手机、平板、智能终端等端侧设备需求，也用于云端边缘推理，支持与 3D 堆叠等先进存储技术融合，进一步提升处理效能、拓展应用边界。 问：智能眼镜市场前景广阔，呈现出快速增长的态势，公司针对 AI 眼镜市场是否有相关的自研产品或者定制产品处于开发中？ 答：公司在智能眼镜领域进行了深入的技术布局，具备智能眼镜所需要的多种技术。 在低功耗核心能力上，公司长期耕耘于通讯/可穿戴/手机芯片市场，对于大型 SoC 低功耗技术有深厚的技术积累，可充分满足智能眼镜对极致功耗的严苛要求；工艺设计层面，公司不仅拥有多工艺节点的产品覆盖及量产经验，还持续向更先进的工艺节点深耕，为产品性能与功耗的平衡提供坚实支撑。 通讯互联方面，公司已构建起多元化协议支持能力：针对智能眼镜需求的低功耗 5G（RedCap）技术已实现量产，处于业内领先水平，可提供高效低功耗的蜂窝通讯服务；同时，BT、GPS、Wi-Fi 等非蜂窝互联技术也已成熟落地，广泛应用于多款自研产品中，能全面覆盖智能眼镜的各类互联场景。此外，公司储备了大量 DPU、ISP 等显示与图像处理 IP，且已在手机产品中经过大规模实践验证，可为智能眼镜提供高性能的显示输出与拍摄解决方案；自研的端侧 NPU 技术同样具备成熟应用基础，已成功搭载于手机产品，后续可为智能眼镜产品提供必要的 AI 性能。 对于自研智能穿戴类产品，公司正在规划和开发中，力争为眼镜产品系列提供高性能低成本的解决方案。对于客户的定制产品，限于保密要求，不便披露。
--	---

	问：公司是否承接纯人力外包的后端版图设计业务？原因是什么？ 答：公司通常采用 Turnkey 的模式，为客户提供从设计到量产的一站式服务，包括前道的 Spec In、后道芯片设计及最终项目验收后的量产供货，并不承接纯人力外包业务，这类业务跟公司的业务模式不符，且公司不认为这种业务模式具有较好的盈利性。 问：请问公司芯片定制业务的发展历程如何？是否具备云端 AI 芯片的设计经验？ 答：在 2018 年国内开始有 AI 云端芯片开发，公司定制业务正是从这个方向上开始启动。在 2018-2022 年间，公司完成了 6 颗国内企业的云端 AI 芯片设计服务，占据了整个中国 AI 云端芯片设计服务市场的相当份额。2022 年后，考虑到地缘政治带来的流片限制等因素，公司在保证流片合规性要求的前提下，继续开拓了国内 RISC-V 高性能芯片定制市场并成为其主要参与者。 2024 年下半年 AI 大模型兴起后，公司通过探索合规的云端 AI 芯片方案来满足不断增长的云端 AI 芯片定制业务需求，充分利用已有的丰富云端 AI 芯片设计经验，在定制服务项目上优先选择 CSP 厂商、系统厂商等头部客户进行合作。 问：近期高通计划推出面向数据中心的人工智推理芯片 AI200（2026 商用）和 AI250（2027 商用），公司是否有相关设计能力或布局？ 答：高通 AI200 主要是通过 LPDDR 存储为大语言模型、多模态模型及其他 AI 工作提供性价比高的云端 AI 解决方
--	--

	案，相较 HBM 方案有明显的成本优势。A250 主要是针对超高带宽的 AI 方案。 公司在云端 AI 推理的 ASIC 项目中，在满足合规性要求的基础上，针对不同客户的定制需求，既开发了高性价比的 LPDDR 方案来满足大规模应用，也有 3D DRAM 接口在内的技术来满足超高带宽应用。 备注：需特别说明的是，本次交流活动问答回复中，所有关于未来业务发展的预期，因预测周期距当前时点尚有一定时间跨度，政策环境、市场情况、项目进度等客观因素可能存在动态变化，具体数据以当年审计数字为准，请投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无